



IEC 電子部品品質認証制度(IECQ)
電子部品/組立部品/関連材料/関連工程
IECQ の規則及び詳細についてはウェブサイト参照 www.iecq.org

IECQ適合証明書 プロセス認証 製造事業者

IECQ 証明書番号:	IECQ-P JQAJP 13.0009	発行番号:	4	認証状況:	継続中
旧 IECQ 証明書番号:	IECQ-P JQAJP 13.0009 第 3 版	発行日:	2018/12/28	初回発行日:	2011/02/14
CB 管理番号:	JQAQ0014-001-M	有効期限:	2022/02/17		

株式会社 国見メディアデバイス

〒969-1771 福島県伊達郡国見町大字山崎字北町田 3 番地

当該組織が開発し、実施する手順及び関連する工程は、この認証書を発行したIECQ認証機関による審査の結果、IECQプロセス認証スキームの要求事項に適合することを確認しました。審査は、基本規則IECQ01、施行規則IECQ03-1「全IECQスキームの一般要求事項」、IECQ03-2「IECQプロセス認証スキーム」及び以下の規格または仕様書に基づいています。:

- 認証対象部品仕様書は添付 附属書を参照
- ISO9001:2015 : 品質マネジメントシステム — 要求事項

参照プロセスマニュアル: EIK000-04-M05-01

認証範囲:

個別半導体デバイス、集積回路、混成集積回路の設計・開発、製造、試験

詳細は添付附属書参照

発行認証機関 (CB) : Japan Quality Assurance Organization (JQA)

一般財団法人 日本品質保証機構 総合製品安全部門

〒192-0364 東京都八王子市南大沢四丁目 4 番地 4

部門長: 近 藤 繁 幸



JQA



Japanese Industrial Standards Committee

日本工業標準調査会

後援会員団体

この認証の妥当性は、この認証書の発行認証機関による定期的なサーベイランス調査の実施によって維持されます。

注記: この認証は IECQ の施行規則に基づき、認証の停止又は取り消しとなる場合があります。

この認証書及びその附属書はその一部のみを複製することはできません。

この認証は委譲できません。また、この認証書の著作権は発行認証機関に属します。

この認証の認証状況及びその真偽については、IECQ の公式ウェブサイトを確認できます。 www.iecq.org



IEC 電子部品品質認証制度 (IECQ)
電子部品/組立部品/関連材料/関連工程
IECQ の規則及び詳細についてはウェブサイト参照 www.iecq.org

附属書

プロセス認証 適合証明書の範囲の詳細

IECQ 証明書番号: IECQ-P JQAJP 13.0009

CB管理番号: JQAQ 0014-001-M

別添番号: IECQ-P JQAJP 13.0009-S

改訂番号: 4 改訂日: 2018/12/28

ページ 1/1

仕様書及び規格

IEC 60747-1:2006

半導体デバイス

— 第 1 部: 一般

IEC 60748-1:2002

半導体デバイス — 集積回路

— 第 1 部: 一般

IEC 60748-20:1988

半導体デバイス・集積回路

— 第 20 部: 膜集積回路及び混成膜集積回路の品目別通則

ISO 9001:2015

品質マネジメントシステム — 要求事項

部 品

個別半導体デバイス、集積回路、混成集積回路

適用範囲

個別半導体デバイス、集積回路、混成集積回路の
設計・開発、製造、試験

この附属書は、認証書と使用したときのみ有効です。
この認証書及びその附属書はその一部のみを複製することはできません。
この認証は委譲できません。また、この認証書の著作権は発行認証機関に属します。
この認証の認証状況及びその真偽については、IECQ の公式ウェブサイトで確認できます。 www.iecq.org



一般財団法人 日本品質保証機構 総合製品安全部門 (JQA)

〒192-0364 東京都八王子市南大沢四丁目 4 番地 4